

芯联集成电路制造股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行和落实“以投资者为本”的发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，公司于 2025 年 4 月 29 日公布《芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，于 2025 年 8 月 5 日公布《芯联集成电路制造股份有限公司关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2025 年度，公司以“提质增效重回报”行动方案为指引，通过系统性部署与精准执行，在提升经营效能、加速科技创新、优化股东价值回报等关键领域取得积极成效。

2026 年，公司将继续锚定“连结资源、汇聚智慧、持续创新、鼎力支撑全球智慧型新能源革命”的愿景，秉承“创新科技 点亮地球”的使命，积极开展“提质增效重回报”专项行动。公司将通过精细化管控体系升级与战略性资源配置优化，全面提升经营能效与资产回报水平；同步强化股东权益保障机制，构建长期资本增值通道，切实转化企业成长动能；将股权激励设定与公司成长深度共建，实现管理层与股东等风险共担、价值共创，持续夯实可持续发展基石。

一、将精益生产与数智化应用相结合，打造高效、智能生产体系

在产能建设方面，2025 年公司初步完成了前期产能建设，构建了 8 英寸硅基、12 英寸硅基产线、6/8 英寸碳化硅三大产线，晶圆年生产量 251.27 万片（折合 8 英寸），同比增长 24.68%。2025 年公司通过持续推动精益生产管理和数智化结合，全面梳理生产工艺流程，明确各工艺节点的衔接关系，同时评估流程信息化程度，推动数智化升级；提升员工方面、应用数智化工具等多方面措施，提升产线效率，降低生产成本，提高市场竞争力。营业收入实现 81.80 亿元，增速达到 25.67%；全年毛利率 5.51%，较上年提高 4.48 个百分点；归母净利润同比减亏 38.17%，盈利能力显著改善。

2026 年公司将继续优化生产工艺和技术、加强生产工艺控制；加强员工培训，提升员工技能水平；根据市场需求和生产能力制定动态、科学合理的生产计

划；运用数智化工具建立异常识别与预警机制、快速响应机制等。通过数智技术的应用、智能制造的升级，为公司盈利改善提供了核心动力。

二、开展前瞻性技术布局，强化创新驱动提升整体竞争力

2025 年公司持续保持高额的研发投入，在人工智能、新能源等前沿技术领域积极推动科技创新，全力促进成果转化。2025 年公司研发投入 19.43 亿元，占营业收入 23.76%。同时公司汇聚了一支技术实力深厚、经验丰富的研发团队，报告期内，公司研发人员合计 1226 人，比去年增加 283 人。其中，硕/博士研究生 761 人，比去年增加 226 人。研发团队的核心成员均为行业内深耕数十年的资深研发技术人员，其卓越的专业能力和创新能力为公司带来了源源不断的技术突破和创新发展，成为了公司持续进步和行业领先的重要保证。报告期内，公司新增获得发明专利等 158 项，累计已获得发明专利等知识产权 574 项。同时公司通过多元化合作与自主创新相结合的方式，在 AI 数据中心、人工智能等多个重点领域开展前瞻性技术布局，不断巩固行业领先的技术研发优势。

2026 年公司将继续深耕产品技术的研发和迭代，通过多元化合作与自主创新相结合的方式，在 AI 数据中心、人工智能等多个重点领域开展前瞻性技术布局，不断巩固行业领先的技术研发优势：（1）精准匹配市场需求，建立科学、标准的研发流程，打通研发需求到产品交付的全链条；（2）强化研发方向、研发项目评估、技术评审与风险管理的高效结合；（3）通过人工智能工具赋能，提高研发效率，缩短重要技术研发周期，加快创新成果转化；（4）建立动态激励机制，将个人发展深度和研发成果深度绑定，激发团队创新活力。

三、深化落实并购重组，通过资源整合创造协同价值

（一）落实并购重组，保障公司可持续发展竞争力

报告期内，公司完成了对控股子公司少数股权的收购，实现了对子公司芯联越州的全资控股，以集中优势资源重点支持 SiC MOSFET 等更高技术产品的研发和业务的发展，进一步强化公司核心竞争力。同时加强 8 英寸硅基产能的管控和整合，能充分发挥产业协同效应，深化公司在芯片系统代工领域的布局，加速推动公司深度整合的进程。

（二）成立合资公司芯港联测，提升检测业务效能

公司已在芯片实验室检测领域深耕数年，在硬件设施、实验设备、软件、技

术、资质、经验和人员等方面有了丰富的积累。在公司体内，芯片检测业务作为辅助增值服务，因独立性原因无法为第三方提供服务，导致设备产能利用率受限，无法直接为公司带来相应经济效益。为盘活内部检测产能、拓展新的业务增长点，公司通过控股子公司芯联先锋与上海临港新片区基金共同出资设立合资检测公司芯港联测。其中，芯联先锋投资 2 亿元，持股 50%。

2026 年将充分落实协同目标、优化资源配置，遵循同类业务集中管理的核心原则，通过全方位的资源和业务整合，集中功能板块，进一步提升公司整体运营效率，降低管理复杂度、提升运营效率，并通过规模化集约经营强化成本优势与整体竞争力，充分发挥协同效应。

四、通过多元化融资渠道，为公司高质量发展提供高效资金支持

（一）快速推进新型政策性金融工具

2025 年基于国家快速落实和推进新型政策性金融工具的契机，公司收到国家开发银行全资子公司国开新型政策性金融工具有限公司人民币 18 亿元，期限 5 年，作为子公司芯联先锋“三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目”的资本金投入。新型政策性金融工具具有资金期限长、利率低等优势，有效地降低公司的整体资金成本，减轻公司融资负担。

（二）完成国内首单集成电路民营企业科技创新债券发行

为满足公司快速发展的资金需求，优化公司债务结构，降低财务费用，2025 年公司向中国银行间市场交易商协会申请并获注册，完成国内首单集成电路民营企业科技创新债券发行，发行金额为 5 亿元人民币，全场认购倍数 3.64，最终发行利率 1.6%，为公司高质量发展提供低成本资金支持。

（三）完成三期项目战略融资

报告期内，公司引进信石信芯、信石华芯、华芯锋基金三家重量级投资机构，为三期 12 英寸硅晶圆制造项目（简称“三期项目”）注入资本金 4.36 亿元。信石信芯、信石华芯、华芯锋基金作为专注于半导体领域的专业投资平台/基金，为公司带来了产业资源、技术合作和市场渠道等多方面的协同效应，助力公司的长远发展。截至报告期末公司已基本完成三期项目战略融资，股权融资合计 132.92 亿元。三期项目的实施，将填补国内在该领域的技术空白，提升高端模拟芯片领域的国产替代能力。

2026 年公司将根据业务发展的实际需求，建立全面的融资管理体系，丰富融资渠道；密切关注国家政策导向，充分利用政策红利；主动适应金融市场变化，创新融资模式，优化融资结构合理确定融资结构；进一步使用资金相关人工智能工具，提高资金使用效率管理；建立风险预警机制，严控负债率水平。确保融资资金高效支持企业高质量发展，为可持续发展奠定坚实的资金基础。

五、完善公司治理结构和内控体系建设，夯实治理结构

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。2025 年公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司经营发展需求，取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权；不再设置监事，董事会增设职工代表董事两名；修订《公司章程》；修订/制定了 36 项公司治理制度；根据业务发展需要，全面修订《内控制度》。通过持续完善公司治理结构和内控体系建设，健全内部控制体系，夯实科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构，提高了公司规范运作水平。

同时公司在报告期内召开 4 次股东大会审议通过 15 项议案；召开 10 次董事会审议通过 47 项议案；召开 7 次监事会审议通过 20 项议案。董事会审计委员会召开 5 次会议及 2 次年报事项沟通会议，董事会战略与可持续发展委员会会议召开 2 次，薪酬与考核委员会会议召开 3 次，独立董事专门会议召开 3 次。以上会议均有效发挥董事会、监事会、董事会专门委员会及独立董事的作用，提高了董事会的治理能力。

同时，多次组织董监高进行相关培训，如董事会秘书后续培训、上市公司独立董事后续培训、独立董事履职平台学习等；多次组织董事会办公室工作人员参加证券市场法律法规相关培训，如参加上交所 2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训、上市公司市值管理专题培训、上市公司高质量发展系列培训-可持续发展(ESG)报告编制专题、上市公司财务规范运作重点关注事项专题培训；多次组织董事会办公室工作人员参加专业知识培训；如组织参加上市公司董办人员专题学习班、上市公司 2024 年度信息披露与编制操作培训、上市公司董办人员信息披露实务培训等。

2026 年公司将通过持续完善公司治理结构和内控体系建设，健全内部控制

体系，夯实科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构，提高公司规范运作水平。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月17日